



Edition 1.0 2025-10

NORME INTERNATIONALE

Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles -

Partie 3-302: Détection des défauts de métallisation dans les cartes de circuits imprimés nus par tomographie informatisée (TI)

Document Preview

<u> 1EC 61189-3-302:2025</u>

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/07b7721d-9a5b-469c-84d8-75b935062d48/iec-61189-3-302-202



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED Copyright © 2025 IEC, Geneva, Switzerland

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Secretariat Tel.: +41 22 919 02 11

3, rue de Varembé info@iec.ch CH-1211 Geneva 20 www.iec.ch

Switzerland

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just
Published détaille les nouvelles publications parues.
Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contacteznous: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications, symboles graphiques et le glossaire. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 500 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 25 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/07b7721d-9a5b-469c-84d8-75b935062d48/iec-61189-3-302-202

IEC 61189-3-302:2025 © IEC 2025

SOMMAIRE

А٧	/ANT-P	ROPOS	3
1	Doma	aine d'application	5
2	Réféi	rences normatives	5
3	Term	es et définitions	5
4		ipe d'essai	
5		reil	
J	5.1		
	5.1.1	Scanneur TI à rayons X	
	5.1.1		
	5.1.2		
	5.1.3	,	
	5.2	Systèmes logiciels	
6		onnement d'essai	
-		i des étapes	
7		•	
	7.1	Préparation de l'équipement	
	7.2	Serrage de l'échantillon	
	7.3	Paramétrage	
	7.3.1	Sources de rayons X	8
	7.3.2	Methodes de balayage	8
	7.3.3		8
	7.3.4	Nombre de trames balayees	8
	7.3.5	Temps de balayage	
	7.4 7.5		
	7.5 7.5.1	Reconstruction d'image	
	7.5.1	Reconstruction 3D	9
	dards.it 7.5.3	eh al/catalog/standards/lec/II/h///Id_Yahh_4hYc_X4dX_/hhY4hIh/d4X/lec_hI	189-3-302-202 9
	7.5.4	Analyse d'images et traitement des données	9
	7.5.5	Enregistrement de l'image	10
8	Rapp	orts	10
	8.1	Informations de base	10
	8.2	Informations sur le dispositif	10
	8.3	Informations sur l'échantillon	10
	8.4	Paramètres de balayage	10
	8.5	Résultat des mesures	10
An	nexe A	(informative) Images types de défauts de métallisation	11
	A.1	Images types des vides de métallisation	11
	A.2	Image type de défauts de remplissage du cuivre du trou de liaison borgne	11
	A.3	Image type de nodulation	12
	A.4	Images types des plis de métallisation	12
	A.5	Image type de coïncidence entre couches	
An	nexe B	(informative) Identification des vides et analyse statistique	14
	B.1	Identification des vides	14
	B.1.1		
	B.1.2	Trou de liaison	14

IEC 61189-3-302:2025 © IEC 2025

B.1.3 T	rou de remplissage	15
B.2 Analy	se statistique	16
B.2.1 N	lombre de vides	16
B.2.2 C	Calcul de la longueur maximale du rapport vides/épaisseur de la carte	16
B.2.3 T	aux de vide calculé des trous remplis	16
Bibliographie		17
Figure 1 – Proce	essus classique d'une analyse TI	5
Figure A.1 – Vid	es de métallisation	11
Figure A.2 – Dé	fauts de remplissage du cuivre du trou de liaison borgne	12
Figure A.3 – No	dulation de métallisation	12
Figure A.4 – Plis	s de métallisation	13
Figure A.5 – Co	ïncidence entre couches	13
Figure B.1 – Ima	age de reconnaissance des vides de trous de métallisation	14
Figure B.2 – Ide	ntification du vide dans le sens de l'épaisseur de la carte	15
Figure B.3 – Ima	age de reconnaissance des vides de trous de remplissage	15
Figure B.4 – Ima	age du vide de microtrou de liaison empilé	15
	emples de référence de la correspondance entre la taille de foyer et ataile pour la taille de foyer source	6
Tableau 2 – Exe	emples de référence de la résolution d'imagerie du système de	
détection corres	pondant au champ de vision d'imagerie	6

Document Preview

IEC 61189-3-302:2025

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/07b7721d-9a5b-469c-84d8-75b935062d48/iec-61189-3-302-2023